

2018年1月10日

報道関係者各位

セメダイン株式会社

ネプコンジャパン2018 『第19回電子部品・材料 EXPO』出展

セメダイン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:岡部 貴)は、ネプコンジャパン2018『第19回電子部品・材料 EXPO』(会期:2018年1月17日~19日 会場:東京ビッグサイト)に出展します。

セメダインブースでは「強い接着から剥がれない接着へ」をコンセプトに、熱・水・衝撃に強く、はがれにくい強靱な接着力を有する弾性接着剤や高強度接着剤など、さまざまな製品をご紹介します。更にセメダインの最先端技術をご紹介しますプレゼンテーションを行う他、HAKUTOプロジェクトコーナーでは、世界初の月面探査レース「Google Lunar XPRIZE」に挑戦している日本の民間月面探査チーム「HAKUTO」の月面探査機『SORATO』を展示します。



(ブースイメージ)

■主な出展製品

- ・従来の一液加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤を進化させ、高耐熱・高強度かつ靱性を有した「EP122」
- ・弾性接着剤とエポキシ樹脂系接着剤の性能を併せ持つハイブリッドタイプ「EP001」シリーズ
- ・弾性接着剤「スーパーX」シリーズに新たに加わった高耐熱タイプ「SX7700」シリーズ

この他にもアクリル系接着剤「メタルロック」シリーズなど、様々な製品を取り揃えております。

■展示会概要

名称:ネプコンジャパン2018『第19回電子部品・材料 EXPO』

会期:2018年1月17日(水)~19日(金) 10:00~18:00(最終日のみ 17:00 迄)

会場:東京ビッグサイト(東京都江東区有明 3-11-1)

主催:リード エグジビション ジャパン株式会社

概要:エレクトロニクス製品の高機能化・軽薄短小化を支えるあらゆる電子部品・電子材料が一堂に出展する専門技術展

セメダインブース番号:東2ホール(E17-40)

【セメダイン株式会社について】

セメダイン株式会社は、1923年の創業以来、日本初の合成接着剤メーカーとして「つける技術」をモノづくりのソリューション技術として提供し続けています。その技術は、輸送機製造や交通システム、産業機器製造、電機製品・電子部品に広く採用されているほか、ビルや住宅、各種インフラやテーマパークなど多くの建設現場を支えています。また、セメダインが実現した“強い接着から剥がれない接着へ”という新しいコンセプトの「弾性接着剤」は、民間月面探査チーム「HAKUTO」の月面探査ローバーにも応用されています。

詳しくはウェブサイト(<http://www.cemedine.co.jp>)をご覧ください。

このリリースに関するお問い合わせ先

セメダイン株式会社 広報室

TEL:03-6421-7375

セメダイン株式会社

〒141-8620 東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー18階

TEL:03-6421-7411

<http://www.cemedine.co.jp>